

電子機器半導体デバイスの故障問題解決

京都実装技術研究会は昭和62年に発足し、電子機器生産の基板技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化や課題解決などの問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和元年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを下記のとおり開催します。

今回は、故障の解析方法とその解決方法についての講習会を開催します。ぜひご参加ください。

記

◇日 時 令和元年5月23日(木) 13:00~17:00

◇場 所 京都府産業支援センター(京都府中小企業技術センター)5階研修室
京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区 南西側

◇テーマ 電子機器および半導体デバイスの故障問題の解決!

~故障解析手順と未然防止手法について~

講師 故障物性ソリューション 味岡 恒夫 氏

講師は、日本信頼性学会故障物性研究会で副主査を務められ同研究会の運営に係わるとともに、故障に関する知識修得、信頼性技術や管理の向上といった活動を通じて、環境や安全を社会に貢献しています。

今回は、以下の3つのアプローチから故障問題の解決方法についてご講演をいただきます。

- (1) 故障がなぜ起こるか?
(電子部品のストレス耐性と部品調達における課題)
- (2) 市場故障に対する対応
(故障解析の進め方とその問題点)
- (3) 実装基板の故障解析
(ロックイン発熱解析を用いた事例)

◇定 員 70名(先着順・定員になり次第、締切りとします。)

※ 定員を超えるなど受講いただけない場合は、ご連絡します。

◇参加費 無料

◇申込締切日 令和元年5月21日(火)まで

◇問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課(京都実装技術研究会事務局)
電話 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134

◇申込先 同上

令和元年度 京都実装技術研究会オープニングセミナー 参加申込票				
会社名				
所在地				
参加者氏名	所属	TEL	E-mail	研究会入会案内の送付を希望※
				する・しない

申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

※ すでに入会申込済みの方は「しない」に○を付けて下さい。